

MEMS Packaging – Leistungsangebot

Technologie:

Elektrische Kontaktierung	Klebertechnik	Heissiegeln/ Laminieren
<ul style="list-style-type: none"> ○ Drahtbonden <ul style="list-style-type: none"> ○ ball wedge ○ wedge wedge 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Passivierung ○ Verkapseln ○ Dichten ○ Kleben zur Montage <ul style="list-style-type: none"> ○ Dispensertechnik ○ Transfertechnik ○ Kapillares Kleben 	Silizium – Polymer Polymer – Polymer Pyrex – Polymer Metall -Polymer
<ul style="list-style-type: none"> ○ Leitkleben ○ Dispensertechnik ○ Transfertechnik 	<ul style="list-style-type: none"> ○ adhesive bonding mit SU-8 	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Löten <ul style="list-style-type: none"> ○ Reflowprozess ○ Laserlöten 		

Gehäusung:

Kundenspezifisch	moulded interconnect devices (HSG-IMAT)	Prototypenherstellung
<ul style="list-style-type: none"> ○ Kunststoffgehäuse ○ Metallgehäuse 		

Montagetechniken:

- surface mount devices
- chip on board
- flip chip
- multi chip module
- Systemintegration

Ansprechpartner:

Dipl.-Ing. H. Ashauer

Tel. 07721 943 224

Fax. 07721 943 210

e-mail: heidi.ashauer@hsg-imit.de